

## BYK-ET 3060

水系セパレーターコーティングおよび負極スラリー用のシリコン界面活性剤  
表面張力を大幅に低下させ、基剤の濡れとレベリングが向上

### 製品データ

#### 組成

ポリエーテル変性シロキサン

#### 一般性状

本データシートに記載した数値は代表値であり、品質規格ではございません。

密度(20 °C):	1.02 g/ml
不揮発分 (10分, 150 °C):	85 %
表面張力 (0.2 % in water):	21 N/m
電気化学的安定性:	0.1 V ~ 4.8 V (vs. Li/Li <sup>+</sup> )

### 適用分野

#### エネルギー貯蔵

##### 特長

BYK-ET 3060 は、水系セパレーターコーティングと負極スラリーの表面張力を大幅に低下させるため、特に基剤の濡れとレベリング性を向上させます。これにより多孔質ポリオレフィンセパレーターと負極銅箔への高速で欠陥のないコーティングが可能となります。

##### 推奨添加量

全配合に対して添加剤として、0.1-1%

上記推奨添加量は初期値として記載しております。最適添加量はラボ試験を行い決定して下さい。

##### 添加方法

最終配合にBYK-ET3060を添加することが望ましいですが、製造中のどの段階でも添加できます。

ビックケミー・ジャパン株式会社  
本 社: 東京都新宿区市谷本村町3-29  
大 阪: 大阪市北区堂島浜1-4-4  
[www.byk.com/jp](http://www.byk.com/jp)



**BYK-Chemie GmbH**  
P.O. Box 10 02 45  
46462 Wesel  
Germany  
Tel +49 281 670-0  
Fax +49 281 65735

[info@byk.com](mailto:info@byk.com)  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® and Y 25® are registered trademarks of the BYK group.

The information herein is based on our present knowledge and experience. The information merely describes the properties of our products but no guarantee of properties in the legal sense shall be implied. We recommend testing our products as to their suitability for your envisaged purpose prior to use. No warranties of any kind, either express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are made regarding any products mentioned herein and data or information set forth, or that such products, data or information may be used without infringing intellectual property rights of third parties. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments.

This issue replaces all previous versions.